



## **Räumliche elektronische Baugruppen (3D-MID): Werkstoffe, Herstellung, Montage und Anwendungen für spritzgegossene Schaltungsträger**

*Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG*

 **Download**

 **Online Lesen**

**Räumliche elektronische Baugruppen (3D-MID): Werkstoffe, Herstellung, Montage und Anwendungen für spritzgegossene Schaltungsträger** Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

 [Download Räumliche elektronische Baugruppen \(3D-MID\): Werkstoff ...pdf](#)

 [Online Lesen Räumliche elektronische Baugruppen \(3D-MID\): Werksto ...pdf](#)

# **Räumliche elektronische Baugruppen (3D-MID): Werkstoffe, Herstellung, Montage und Anwendungen für spritzgegossene Schaltungsträger**

*Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG*

**Räumliche elektronische Baugruppen (3D-MID): Werkstoffe, Herstellung, Montage und Anwendungen für spritzgegossene Schaltungsträger** Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

**Downloaden und kostenlos lesen Räumliche elektronische Baugruppen (3D-MID): Werkstoffe, Herstellung, Montage und Anwendungen für spritzgegossene Schaltungsträger Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG**

---

378 Seiten

Pressestimmen

"Dieses Buch gibt einen umfassenden Überblick über den aktuellen Stand der 3D-MID-Technik".

Kunststoffe, April 2013

"[Sie] finden in diesem Buch eine sehr umfangreiche und strukturierte Übersicht über diese Technologie."

Prof. Dr.-Ing. Ernst Schmachtenberg, Rektor RWTH Aachen, Kunststoffe, Dezember 2013

Kurzbeschreibung

Räumliche elektronische Baugruppen (MID - Molded Interconnect Devices) ermöglichen die Integration mechanischer, elektronischer, optischer, thermischer und fluidischer Funktionen auf spritzgegossenen Komponenten. Mit der Funktionsintegration einher gehen eine hohe geometrische Gestaltungsfreiheit sowie die Möglichkeit der Miniaturisierung von Bauteilen, einer damit verbundenen Gewichtsreduktion und einer Senkung der Produktkosten. Da MID überwiegend aus rezyklierbaren Thermoplasten hergestellt werden, sind sie zudem umweltverträglicher als alternativ zur Verfügung stehende Technologien.

MID werden in nahezu allen elektronischen Bereichen eingesetzt. Insbesondere in der Automobilindustrie gibt es eine Reihe von MID-Serienanwendungen, die damit gleichzeitig Motor für weitere Entwicklungsarbeiten zur Technologie MID sind. Auch für die Medizintechnik, die IT- und Telekommunikation sowie die Industrieautomatisierung gewinnt die MID-Technologie zunehmend an Bedeutung und zahlreiche Applikationen werden bereits erfolgreich umgesetzt.

Dieses Buch gibt einen umfassenden Überblick über den aktuellen Stand der 3D-MID-Technik entlang der gesamten Prozesskette. Darüber hinaus werden in jeweils eigenen Kapiteln Systematiken zur zielgerichteten Entwicklung von MID-Bauteilen vorgestellt sowie an mehr als einem Dutzend erfolgreicher MID-Serienapplikationen die vielfältigen Einsatzgebiete der MID-Technologie aufgezeigt.

Inhalt

Mechatronische Integrationspotenziale durch MID

Werkstoffe

Formgebungsverfahren

Strukturierung

Metallisierung

Montagetechnik

Verbindungstechnik

Qualität und Zuverlässigkeit

Prototyping

Integrative Entwicklung von MID-Bauteilen

Fallstudien Buchrückseite

Räumliche elektronische Baugruppen (MID – Molded Interconnect Devices) ermöglichen die Integration mechanischer, elektronischer, optischer und thermischer Funktionen auf spritzgegossenen Teilen. Mit der Funktionsintegration einher gehen eine hohe geometrische Gestaltungsfreiheit sowie die Möglichkeit der Miniaturisierung von Bauteilen, einer damit verbundenen Gewichtsreduktion und einer Senkung der Produktkosten. Da MID überwiegend aus rezyklierbaren Thermoplasten hergestellt werden, sind sie zudem umweltverträglicher als alternativ zur Verfügung stehende Technologien.

MID-Bauteile werden inzwischen in nahezu allen elektronischen Bereichen eingesetzt. Insbesondere in der Automobilindustrie gibt es eine Reihe von MID-Serienfertigungen, die damit gleichzeitig Motor für weitere Entwicklungsarbeiten zur Technologie MID sind. Auch für die Medizintechnik, die IT- und Telekommunikation und die Industrieautomatisierung gewinnt die MID-Technologie stetig an Bedeutung und erste Serienanwendungen werden erfolgreich umgesetzt.

Wichtige Anwendungsfelder sind Sensoren, Antennen (insbesondere im Mobilfunksektor), 3D-Verdrahtungen sowie Schaltungsträger, Gehäuse und Steckverbinder. Auch die Integration optischer Funktionen, z. B. in der Beleuchtungstechnik mit LEDs, gewinnt an Bedeutung.

Das Buch gibt einen umfassenden Überblick über den aktuellen Stand der 3D-MID-Technik entlang der gesamten Prozesskette. Darüber hinaus werden in jeweils eigenen Kapiteln Systematiken zur erfolgreichen Entwicklung von MID-Bauteilen vorgestellt sowie an mehr als einem Duzend laufender MID-Serienapplikationen die vielfältigen Einsatzgebiete der MID-Technologie gezeigt.

Inhalt

Mechatronische Integrationspotenziale durch MID

Werkstoffe

Formgebungsverfahren

Strukturierung

Metallisierung

Montagetechnik

Verbindungstechnik

Qualität und Zuverlässigkeit

Prototyping

Integrative Entwicklung von MID-Bauteilen

Fallstudien

Download and Read Online Räumliche elektronische Baugruppen (3D-MID): Werkstoffe, Herstellung, Montage und Anwendungen für spritzgegossene Schaltungsträger Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

#U3WZ1QTHFP8

Lesen Sie Räumliche elektronische Baugruppen (3D-MID): Werkstoffe, Herstellung, Montage und Anwendungen für spritzgegossene Schaltungsträger von Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG für online ebook Räumliche elektronische Baugruppen (3D-MID): Werkstoffe, Herstellung, Montage und Anwendungen für spritzgegossene Schaltungsträger von Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG Kostenlose PDF d0wnl0ad, Hörbücher, Bücher zu lesen, gute Bücher zu lesen, billige Bücher, gute Bücher, Online-Bücher, Bücher online, Buchbesprechungen epub, Bücher lesen online, Bücher online zu lesen, Online-Bibliothek, greatbooks zu lesen, PDF Beste Bücher zu lesen, Top-Bücher zu lesen Räumliche elektronische Baugruppen (3D-MID): Werkstoffe, Herstellung, Montage und Anwendungen für spritzgegossene Schaltungsträger von Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG Bücher online zu lesen. Online Räumliche elektronische Baugruppen (3D-MID): Werkstoffe, Herstellung, Montage und Anwendungen für spritzgegossene Schaltungsträger von Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG ebook PDF herunterladen Räumliche elektronische Baugruppen (3D-MID): Werkstoffe, Herstellung, Montage und Anwendungen für spritzgegossene Schaltungsträger von Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG Doc Räumliche elektronische Baugruppen (3D-MID): Werkstoffe, Herstellung, Montage und Anwendungen für spritzgegossene Schaltungsträger von Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG Mobipocket Räumliche elektronische Baugruppen (3D-MID): Werkstoffe, Herstellung, Montage und Anwendungen für spritzgegossene Schaltungsträger von Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG EPub